(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-231104 (P2000-231104A)

(43)公開日 平成12年8月22日(2000.8.22)

(51) Int.Cl.'		裁別記号	· PI			5-73-1°(多考)
G02F	1/1335	530	G 0 2	F 1/1335	530	2H091
	1/1345			1/1345		2H092

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 7 頁)

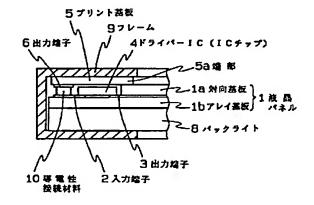
特顏平11-32927	(71) 出題人 595059056
·	株式会社アドバンスト・ディスプレイ
平成11年2月10日(1999.2.10)	熊本県菊池郡西合志町御代志997番地
	(72)発明者 大槻 英明
	熊本県菊池郡西合志町御代志997番地 株
	式会社アドバンスト・ディスプレイ内
	(74) 代型人 100065226
	护理士 朝日奈 宗太 (外1名)
	Fターム(参考) 2H091 FA41Z GA13 LA09 LA12
	21092 GA47 GA54 GA57 GA60 NA18
	NA29 PA05 PA13

(54) 【発明の名称】 液晶皮示装置

(57)【要約】

【課題】 フレームを被せる際にプリント基板が位置ずれを起こさずに、液晶パネルとブリント基板を確実、かつ、容易に接続することができる液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 アレイ芸板1bにICチップ4が接続され、かつ該ICチップ4に駆動信号を供給する入力端子2が形成された液晶パネル1と、前記入力端子2に接続される出力端子6が端部に形成されたブリント基板5と、前記液晶パネル1の入力端子2とブリント基板5の出力端子6とのあいだに挟まれる導電性接続材料10と、前記液晶パネル1とブリント基板5をかしめるフレーム9と、前記液晶パネル1に光を供給するパックライト8を備える液晶表示装置であって、前記ブリント基板5の出力端子6が形成されていない端部5aが、前記液晶パネル1の対向基板1aの上に載った状態で、前記フレーム9によって前記ブリント基板5と液晶パネル1がかしめられている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 アレイ基板に【Cチップが接続され、か つ該ICチップに駆動信号を供給する入力端子が形成さ れた液晶パネルと、前記入力端子に接続される出力端子 が端部に形成されたブリント基板と、前記液晶パネルの 入力端子とブリント基板の出力端子とのあいだに挟まれ る導電性接続材料と、前記液晶パネルとプリント基板を かしめるフレームと、前記液晶パネルに光を供給するパ ックライトを備える液晶表示装置であって、前記プリン ト基板の出力端子が形成されていない端部が、前記液晶 10 パネルの対向基板の上に載った状態で、前記フレームに よって前記プリント基板と液晶パネルがかしめられてな ることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記プリント基板と液晶パネルの対向基 板とが重なった部分に、クッション材が配置されてなる ととを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記プリント基板にダミーパターンが形 成されており、前記フレームでプリント基板と液晶パネ ルをかしめた際に、前記ダミーパターンがICチップの 上面に接触してなることを特徴とする請求項1または2 20 記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記プリント基板のダミーパターンと1 Cチップとのあいだにクッション材が配置されてなるこ とを特徴とする請求項3記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記フレームに突起が形成されており、 該突起によって前記導電性接続材料を介して前記プリン ト基板が液晶パネルに加圧されてなることを特徴とする 請求項1、2、3または4記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記フレームの突起とブリント基板との あいだにクッション材が配置されてなることを特徴とす 30 1 b を貼り合わせ、その隙間に液晶が注入されている。 る請求項5記載の液晶表示装置。

【請求項7】 アレイ基板に【Cチップが接続され、か つ該ICチップに駆動信号を供給する入力端子が形成さ れた液晶パネルと、前記入力端子に接続される出力端子 が端部に形成されたブリント基板と、前記液晶パネルの 入力端子とプリント基板の出力端子とのあいだに挟まれ る導電性接続材料と、前記液晶パネルとブリント基板を かしめるフレームと、前記液晶パネルに光を供給するパ ックライトを備える液晶表示装置であって、前記パック が上になるように置き、その上に導電性接続材料を載 せ、前記液晶パネルの対向基板を下にして、設プリント 基板と液晶パネルの位置合わせが行なわれており、その 状態で前記フレームが彼せられ、前記プリント基板と液 晶パネルがかしめられてなることを特徴とする液晶表示 装置。

【請求項8】 前記パックライトに液晶パネルとプリン ト基板を固定するリブが形成されてなることを特徴とす る請求項7記載の液晶表示装置。

いだにクッション材が配置されてなることを特徴とする 請求項7または8記載の液晶表示装置。

【請求項10】 前記フレームに突起が形成されてお り、該突起によって前記導電性接続材料を介して前記プ リント基板が液晶パネルに加圧されてなることを特徴と する請求項7、8または9記載の液晶表示装置。

【請求項11】 前記フレームの突起と液晶パネルのあ いだにクッション材が配置されてなることを特徴とする 請求項10記載の液晶表示装置。

【請求項12】 前記プリント基板にダミーパターンが 形成されており、前記フレームでプリント基板と液晶パ ネルをかしめた際に、前記ダミーパターンが【Cチップ の上面に接触してなることを特徴とする請求項7、8、 9、10または11記載の液晶表示装置。

【請求項13】 前記プリント基板のダミーパターンと ICチップとのあいだにクッション材が配置されてなる ことを特徴とする請求項12記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に関す る。さらに詳しくは液晶表示装置の実装構造における、 ICチップ (以下、ドライバーICという) が接続され た液晶パネルとパスラインが形成されたプリント基板の 接続構造を改良した液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、液晶表示装置の実装構造とし ては、COG(Chip On Glass)実装構造 が広く用いられている。図14にCOG実装構造を示 す。 l は液晶パネルであり、対向基板 l a とアレイ基板 2は液晶パネル1の実装エリアに形成された入力端子で あり、3は出力端子である。4はドライバー【Cであ り、液晶パネル1の入力端子2と出力端子3に接続され る。入力端子2によってドライバーIC4に電源駆動信 号などが供給される。また、出力端子3によって液晶パ ネル1にドライバーIC4の駆動電圧を供給する。5は バスラインが形成されたブリント基板であり、通常フレ キシブル基板が使用される。6はブリント基板5に形成 された出力端子であり、液晶パネル1の入力端子2に接 ライトに前記プリント基板を該プリント基板の出力端子 40 続される。7は制御基板であり、プリント基板5と接続 される。8は液晶パネル1に光を供給するバックライ ト、9は液晶パネル1とバックライト8を固定するフレ ームである。

【0003】一般的に、ドライバーIC4と液晶パネル 1の入力端子2と出力端子3は異方性導電膜によって接 続される。また、プリント基板5の出力端子6と液晶パ ネル1の入力端子2は異方性導電膜やはんだによって接 続される。プリント基板5は可撓性を利用して、バック ライト8の裏面に折り曲げ制御基板7のコネクタ(図示 【請求項9】 前記プリント基板とバックライトとのあ SO せず)に接続され、その上からフレーム9を装着した実 装構造になっている。

【0004】しかし、図14に示す液晶表示装置の実装 構造では、プリント基板5を異方性導電膜やはんだで接 続するため、熱圧着が必要であり、作業性がわるいとい う問題がある。またプリント基板5の交換が難しいとい う問題もある。

【0005】そのため、組立作業と部品交換が容易な実 装構造を行なう液晶表示装置として、特開平6-512 85号公報に示される液晶表示装置がある。図15は、 この液晶表示装置における実装構造を示す要部断面図で 10 ある。図15において、10は導電性接続材料であり、 断面角方形の本体が絶縁性ゴムで本体の厚さ方向に多数 の金属細線が貫通している。11はバックパネルであ る。12はL字型舌片であり、フレーム9とパックパネ ル11の固定に使用されている。

【0006】との液晶表示装置では、バックパネル】】 にパックライト8を置き、その上にドライバーIC4が 接続された液晶パネル 1 を載せる。そして、液晶パネル 1の入力端子2の上に導電性接続材料10を載せ、その 上からブリント基板5を位置合わせする。ついでフレー 20 ム9を被せ、L字型舌片12をバックパネル11にかし めて固定する構造になっている。かかる液晶表示装置で は、組立作業において、はんだ付けや熱圧着などを行な わないため、作業性が良く、また分解が容易であるた め、不良部品の交換を簡単にできる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、かかる 液晶表示装置における実装構造では、プリント基板5 は 導電性接続材料10によってのみ支えられる構造である 5の出力端子6と液晶パネル1の入力端子2が位置ずれ を起とす惧れがある。さらに、フレーム9のL字形舌片 12をバックパネル11にかしめて固定するため、作業 性を低下させる頃れもある。

【〇〇〇8】本発明はかかる課題を解決するためになさ れたものであって、フレームを被せる際に、プリント基 板が位置すれを起こさずに、液晶パネルとブリント基板 を確実、かつ、容易に接続することができる液晶表示装 置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置 は、アレイ基板にICチップが接続され、かつ該ICチ ップに駆動信号を供給する入力端子が形成された液晶パ ネルと、前記入力端子に接続される出力端子が端部に形 成されたブリント基板と、前記液晶パネルの入力端子と プリント基板の出力端子とのあいだに挟まれる導電性接 続材料と、前記液晶パネルとプリント基板をかしめるフ レームと、前記液晶パネルに光を供給するバックライト を備える液晶表示装置であって、前記プリント基板の出 力端子が形成されていない端部が、前記液晶パネルの対 50 出力端子6と液晶パネル1の入力端子2が電気的に接続

向基板の上に載った状態で、前記フレームによって前記 プリント基板と液晶パネルがかしめられてなることを特 徴とする。

【0010】また本発明の液晶表示装置は、アレイ基板 にICチップが接続され、かつ該ICチップに駆動信号 を供給する入力端子が形成された液晶パネルと、前記入 力端子に接続される出力端子が端部に形成されたブリン ト基板と、前記液晶パネルの入力端子とブリント基板の 出力端子とのあいだに挟まれる導電性接続材料と、前記 液晶パネルとプリント基板をかしめるフレームと、前記 液晶パネルに光を供給するパックライトを備える液晶表 示装置であって、前記パックライトに前記プリント基板 を設プリント基板の出力端子が上になるように置き、そ の上に導電性接続材料を載せ、前配液晶パネルの対向基 板を下にして、酸プリント基板と液晶パネルの位置合わ せが行なわれており、その状態で前記フレームが被せら れ、前記プリント基板と液晶パネルがかしめられてなる ことを特徴とする。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、添付図面に基づいて本発明 の液晶表示装置を説明する。図1は本発明の液晶表示装 置の一実施の形態(第1の実施の形態)を示す要部断面 図である。

【0012】図1に示されるように、液晶表示装置は、 アレイ基板 1 b にドライバーIC4が接続され、かつ該 ドライバー 1 C 4 に駆動信号を供給する入力端子2が形 成された液晶パネル1と、前記入力端子2に接続される 出力端子6が端部に形成されたプリント基板5と、前記 液晶パネル1の入力端子2とプリント基板5の出力端子 ため、フレーム9を被せて加圧する際に、プリント基板 30 6とのあいだに挟まれる、ゼブラ接続材料などの導電性 接続材料10と、前記液晶パネル1とブリント基板5を かしめるフレーム9と、前記液晶パネル1に光を供給す るバックライト8を備えている。

> 【0013】前記液晶パネル1は、対向基板1aとアレ イ基板lbを貼り合わせており、その隙間には液晶が注 入されている。入力端子2は、液晶パネル1の実装エリ アに形成される。ドライバー I C 4は、液晶パネル1の 入力端子2と出力端子3に接続されている。 跋入力端子 2によってドライバー I C 4 に電源駆動信号などが供給 40 され、また出力端子3によって液晶パネル1にドライバ -1C4の駆動電圧が供給される。プリント基板5に は、バスラインが形成されている。

【0014】本実施の形態では、ブリント基板5の出力 端子8を導電性接続材料10を介して液晶パネル1の入 力端子2に位置合わせを行ない、かつブリント基板5の 出力端子6が形成されていない端部5 a を対向基板 l a の上に載せた状態で、フレーム9を被せた実装構造とな っている。 該フレーム9によってプリント基板5が導電 性接続材料10に押し付けられると、プリント基板5の

される。また、ブリント基板5は対向基板1aの上に載 り、かつ表示に影響がないように寸法設計されている。 【0015】実施の形態では、ブリント基板5の両端部 が、導電性接続材料10と対向基板1aによって支えら れているため、ブリント基板5の配置状態は安定してお り、フレーム9を被せる際にプリント基板5が位置ずれ を起こすことがない。そのため、組立作業が容易であ り、生産性を向上させることができる。またブリント基 板のずれによる表示不良が発生しないため、歩留りも向 上させるととができる。

【0016】つぎに請求項1記載の発明にかかわる液晶 表示装置の他の実施の形態 (第2の実施の形態)を図2 に基づいて説明する。

【0017】通常プリント基板5はガラスエポキシ材、 対向基板1aはガラス材から作製されており、プリント 基板5の出力端子6が形成されていない端部5 a は、互 いに固い基板同士が接触している。そのため、フレーム 9でプリント基板5を導電性接続材料10に加圧する場。 合、プリント基板5が導電性接続材料10にうまく圧接 されずにオープン不良(隙間)が発生する場合がある。 【0018】そとで、図2に示されるように、本実施の 形態では、ブリント基板5と対向基板1aのあいだにク ッション材13が配置されている。かかるクッション材 13を配置することにより、フレーム9で加圧する際 に、クッション材13が変形し、プリント基板5が導電 性接続材料10に確実、かつ均一に加圧され、接続の信 頼性が向上する。クッション材13は、プリント基板5 の山力端子6が形成されていない端部5 a に両面テープ または接着剤などによって固定されている。なお、本発 明においては、クッション村13はブリント基板5に貼 30 り付いている必要はなく、対向基板laに貼り付けると とができる。または、クッション材13を貼り付けずに 対向基板1aに単に載せ、それからプリント基板5の位 **習合わせを行なってもよい。**

【0019】つぎに請求項1記載の発明にかかわる液晶 表示装置のさらに他の実施の形態(第3の実施の形態) を図3に基づいて説明する。14はブリント基板5に形 成されたダミーパターン(ブリント基板の配線パターン とは電気的に孤立するパターン)である。ダミーパター ン14はCOG実装されたドライバーIC4の上方に形 40 成されている。フレーム9によりブリント基板5を加圧 すると、ブリント基板5のダミーパターン14がドライ バー1C4の上面に接触する。 これにより、ドライバー IC4からの発熱をプリント基板5に放熱させることが でき、ドライバーIC4の誤動作がなくなり、ドライバ ーIC4の信頼性を向上させることができる。 さらに配 線パターンを接地することにより、ノイズによる表示不 良もなくなり、高信頼の液晶表示装置を実現することが

表示装置のさらなる他の実施の形態 (第4の実施の形 態)を図4に基づいて説明する。本実施の形態では、図 4に示されるように、ドライバーIC4とダミーパター ン14とのあいだに、熱導電率および導電率などの高い 材質から作製されるクッション材15を配置している。 かかるクッション材15を配置することにより、ダミー パターン14とドライバー1C4が確実に接続され、一 圏ドライバー I C 4 の信頼性を向上させることができ る。さらに、ドライバーIC4を上面から押さえる構造 であるため、高温環境化でのドライバー【C4の浮き上 りを押さえることができ、高温に対する信頼性が一層向 上する。

【0021】つぎに請求項1記載の発明にかかわる液晶 表示装置のさらなる他の実施の形態(第5の実施の形 態)を図5に基づいて説明する。16はフレーム9の内 面に形成した突起であり、ブリント基板5を導電性接続 材料10に押し付ける部分に形成されている。との突起 16によって、プリント基板5が導電性接続材料10に 加圧されるため、加圧力が大きくなり接続の信頼性を向 20 上させるととができる。

【0022】つぎに請求項1記載の発明にかかわる液晶 表示装置のさらなる他の実施の形態(第6の実施の形 態)を図6に基づいて説明する。図6に示されるよう に、前記フレーム9の突起16にクッション材17を両 面テープまたは接着剤などで貼ることにより、加圧力が 均一になり接続の信頼性をさらに向上させることができ る。なお、本発明においては、クッション材17はブリ ント基板5に貼り付けても、また貼り付けずに置いただ けでも同様の効果がある。

【0023】また、前記図1~8にかかわる実施の形態 を組合わせることによって、一層効果があることは言う までもない。

【0024】つぎに請求項7記載の発明にかかわる液晶 表示装置の実施の形態(第7の実施の形態)を図7に基 づいて説明する。まずプリント基板5をバックライト8 の凹部8aに出力端子6が上になるように置く。 そし て、導電性接続材料10を出力端子6の上に置き、液晶 パネル1の対向基板1aを下にして、ブリント基板5の 出力端子8と液晶パネル1の入力端子2を導電性接続材 料10を介して位置合わせを行ない配置する。 ついで、 液晶パネル1とバックライト8にフレーム9を被せるこ とにより、液晶パネル 1 を導電性接続材料 1 0 に加圧 し、プリント基板5の出力端子6と液晶パネルの入力端 子2を電気的に接続する。

【0025】つぎに請求項7記載の発明にかかわる液晶 表示装置の他の実施の形態(第8の実施の形態)を図8 に基づいて説明する。18はバックライト8に形成され たブリント基板5と液晶パネル1の位置決め用リブであ る。バックライト8の位置決め用リブ18を用いて、液 【0020】つぎに請求項1記載の発明にかかわる液晶 50 晶パネル1とプリント基板5を簡単に位置合わせすると

とができ、生産性が向上する。また、フレーム9を被せ る際にも、プリント基板5と液晶パネル1は位置ずれを 起こさないため、接続の信頼性も向上する。通常プリン ト基板5の出力端子8と液晶パネル1の入力端子2の接 続端子ピッチは500μmピッチ程度と大きいため、リ ブ18によって位置決めをすることができる。

【0026】つぎに請求項7記載の発明にかかわる液晶 表示装置のさらに他の実施の形態(第8の実施の形態) を図9に基づいて説明する。本実施の形態では、図9に 示されるように、バックライト8とプリント基板5との 10 あいだにクッション材19が配置されている。かかるク ッション材19により、フレーム9による加圧力が液晶 パネル1の入力端子2とブリント基板5の出力端子6に 均一に作用し、安定した接続が得られる。クッション材 19は、プリント基板5またはパックライト8に貼り付 けておくことができるが、バックライト8に置くだけで も良い。

【0027】つぎに請求項7記載の発明にかかわる液晶 表示装置のさらなる他の実施の形態(第10~11の実 施の形態)を図10および図11に基づいて説明する。 本実施の形態では、図5に示される実施の形態と同様に 図10に示されるように、フレーム9に突起16を設け ることによって、加圧力が大きくなり接続が安定する。 また、図8に示される実施の形態と同様に図11に示さ れるように、突起18の下にクッション材17を配置す ることにより、加圧力が均一になり一層安定した接続が 得られる。

【0028】つぎに請求項7記載の発明にかかわる液晶 表示装置のさらなる他の実施の形態(第12~13の実 施の形態)を図12および図13に基づいて説明する。 本実施の形態では、図3に示される実施の形態と同様に 図12に示されるように、プリント基板5にダミーパタ ーン14を形成し、フレーム9で加圧した際に、ドライ バー | C 4 とダミーパターン 1 4 を接触させる。 これに よって、ドライバーIC4の発熱、ノイズ対策が実現で き、ドライバーIC4の信頼性を向上させることができ る。また、図4に示される実施の形態と同様に図13に 示されるように、ダミーパターン14とドライバー10 4のあいだに熱伝導率および導電率などの高い材質から 作製されるクッション材15を配置することによって、 一層ドライバーIC4の信頼性を向上させることができ

【0029】また、前記図7~13に示される実施の形 態を組合わせることによって、一層効果があることは言 うまでもない。

[0030]

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明によれば、 プリント基板の両端が導電性接続材料と対向基板によっ て支えられるため、またはプリント基板をパックライト に置き、対向基板を下にして液晶パネルとプリント基板 50 13、15、17、19

の位置合わせを行ない、フレームを被せるため、ブリン ト基板はパックライトの面上で支えられているため、安 定しており、フレームを被せる際に、ブリント基板が位 置ずれを起こさない。そのため、組立作業が容易であ り、かつブリント基板の位置ずれによる表示不良が発生 しない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示装置の第1の実施の形態を示 す要部断面図である。

【図2】本発明の液晶表示装置の第2の実施の形態を示 す要部断面図である.

【図3】本発明の液晶表示装置の第3の実施の形態を示 す要部断面図である。

【図4】本発明の液晶表示装置の第4の実施の形態を示 す要部断面図である。

【図5】本発明の液晶表示装置の第5の実施の形態を示 す要部断面図である。

【図6】本発明の液晶表示装置の第6の実施の形態を示 す要部断面図である.

【図7】本発明の液晶表示装置の第7の実施の形態を示 20 す要部断面図である。

【図8】本発明の液晶表示装置の第8の実施の形態を示 す要部断面図である。

【図9】本発明の液晶表示装置の第9の実施の形態を示 す要部断面図である。

【図10】本発明の液晶表示装置の第10の実施の形態 を示す要部断面図である。

【図11】本発明の液晶表示装置の第11の実施の形態 を示す要部断面図である。

【図12】本発明の液晶表示装置の第12の実施の形態 を示す要部断面図である。

【図13】本発明の液晶表示装置の第13の実施の形態 を示す要部断面図である。

【図14】従来の液晶表示装置におけるCOG実装構造 を示す要部断面図である。

【図15】従来の液晶表示装置における他の実装構造を 示す要部断面図である。

【符号の説明】

液晶パネル 1

1 a 対向基板

1b アレイ基板

入力端子

3, 6 出力端子

ドライバーIC(ICチップ)

5 プリント基板

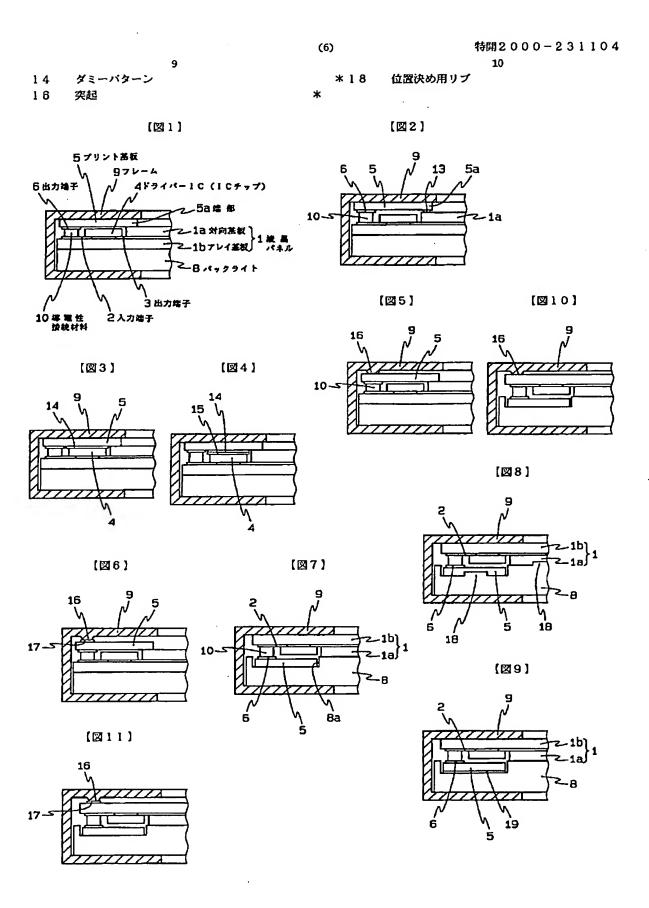
5 a 端部

バックライト

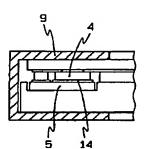
9 フレーム

導電性接続材料 10

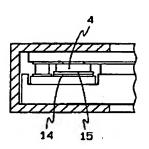
クッション材



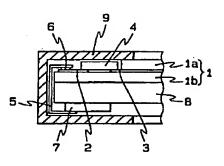
[図12]



[図13]



[図14]



[図15]

